

### EV Group announces next-generation EVG150 resist processing platform – November 8, 2022

EVG announced that it has strengthened its portfolio of optical lithography solutions with the unveiling of the next-generation 200-mm version of its EVG®150 automated resist processing system. The redesigned EVG150 platform includes advanced features and enhancements that provide even greater throughput (by up to 80 percent) and versatility, as well as smaller tool footprint (by nearly 50 percent), compared to the previous-generation platform. The next-generation EVG150 for 200-mm substrates maintains the industry-leading capabilities of the previous-generation platform, including: fully automated platform with customizable module configurations for spin and spray coating, developing, bake and chill.



## EV Group, 차세대 EVG150 레지스트 처리 플랫폼 출시

✎ KIPOST | 🕒 입력 2022.11.08 09:50 | 🕒 수정 2022.11.08 17:10 | 🗨 댓글 0

KIPOST 대학(원)생 특별 할인

학생증 인증 방법 알아보기



웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 전문업체인 EV Group(이하 EVG)은 리소그래피 솔루션 포트폴리오에 속하는 차세대 200mm 제품으로 EVG®150 자동화 레지스트 처리 시스템을 출시한다고 8일 밝혔다.

새로운 디자인의 EVG150 플랫폼은 이전 세대 플랫폼과 비교해 최대 80%까지 높은 생산성과 우수한 범용성, 50% 더 작은 풋프린트가 특징이다. 범용 플랫폼으로서 신뢰할 수 있는 고품질 코팅 및 현상 공정을 지원해 첨단 패키징, MEMS, RF, 3D 센싱, 전력 반도체, 포토닉스를 비롯한 다양한 디바이스 및 애플리케이션에 적용할 수 있다. 새로운 장비는 우수한 생산성과 유연성 및 반복성을 통해 대량 생산과 산업용 개발 양쪽 모두의 까다로운 요구를 충족한다.

세계적인 EBS(electronic based system) 연구 센터인 실리콘 오스트리아 랩스(Silicon Austria Labs)는 차세대 EVG150 시스템의 첫 번째 고객이다.

차세대 EVG150 200mm 플랫폼은 최대 4개의 습식 처리 모듈 공간과 최대 20개의 베이킹-냉각 유닛을 제공해 여러 웨이퍼를 동시에 처리 가능하다. 또 코팅 챔버들을 분리시킴으로써 모듈들을 완벽하게 격리시키고, 모듈 간의 교차 오염을 실질적으로 제거한다.

이와 함께 디자인을 개선해 장비 바깥에서 개별 챔버에 용이하게 접근할 수 있어 챔버 유지보수 작업 시 가동 중단 시간을 최소화하고 계속해서 장비를 가동할 수 있다. 챔버들의 위치를 변경해서 로봇 핸들링 유닛에 용이하게 접근할 수 있으므로 수월한 유지보수도 가능하다.

이밖에 이미지 기반의 프리알라이너(pre-aligner)를 사용해 신속히 웨이퍼 센터링이 가능하므로 처리 시간을 단축하는 한편 시스템 내에 레지스트 및 화학물질 라인을 통합함으로써 화학물질 저장을 위한 외부 캐비닛 공간 절약 및 장비 풋프린트 축소도 구현했다.

<https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=304797>